

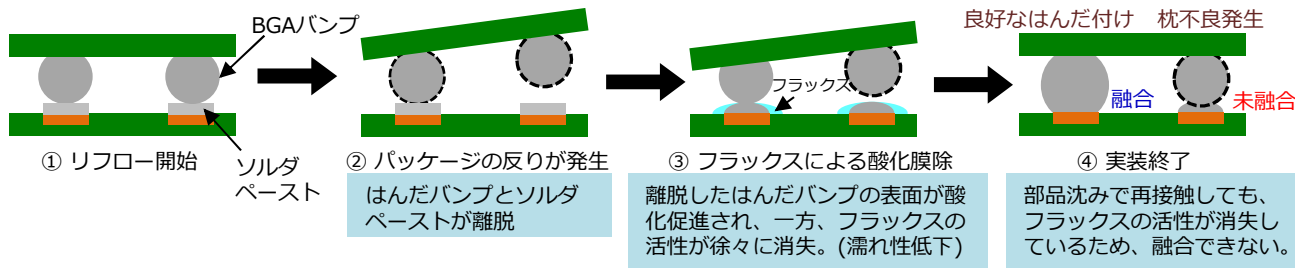
**BGA枕不良対策品**

# PF305-153TO

合金組成：Sn-3.0Ag-0.5Cu

フラックス：ハロゲンフリー (ROLO)

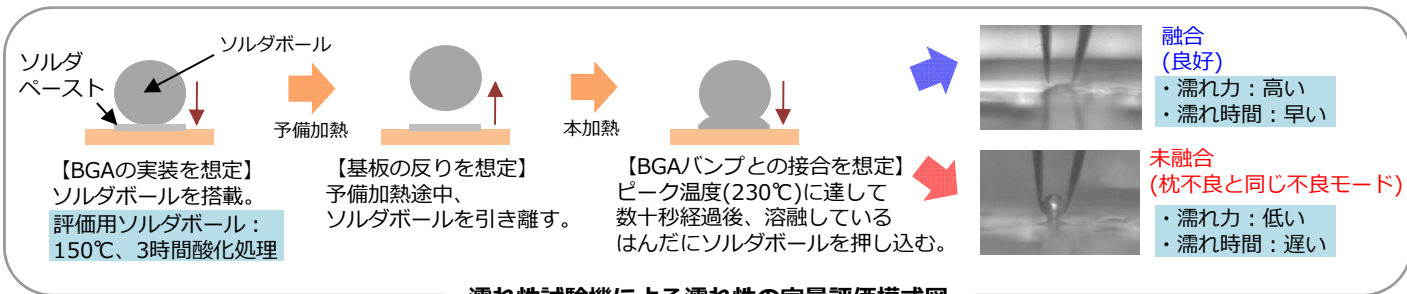
## BGAの枕不良はなぜ起きるのか？



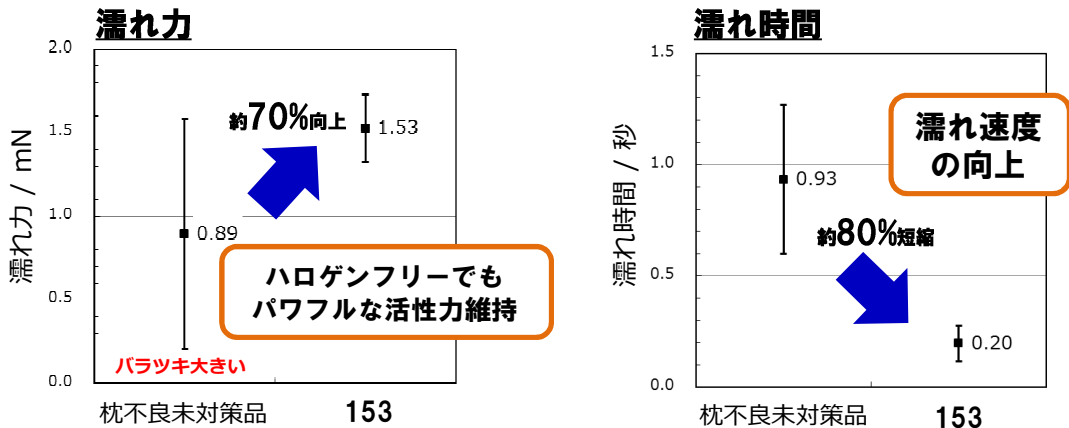
パッケージの反りの影響で発生するBGAの枕不良モード図

### ◆枕不良対策には濡れ性の持続力がポイント

濡れ性試験機で濡れ力、濡れ時間を測定することによって、ソルダペーストの濡れ性を定量的に評価することが可能です。

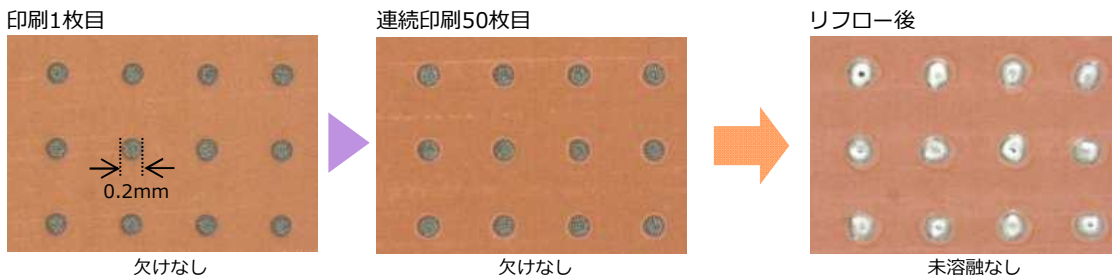


濡れ性試験機による濡れ性の定量評価モード図



### ◆BGA実装に求められる、微小印刷性と微小溶解性を保持

大気リフローでも優れた微小溶解性

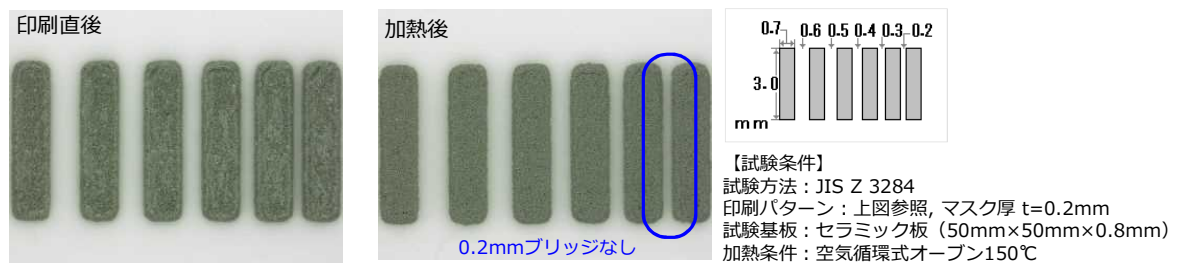


【印刷条件試験基板】  
・試験基板：ガラスエポキシ銅張積層板 (FR4)  
・マスク：ドット径：0.2mmΦ、厚さ0.12mm

【リフロー条件】  
・大気リフロー  
・予備加熱180~190℃、100秒  
・ピーク温度240℃、220℃以上26秒

## ◆優れた加熱だれ抑制・ソルダボール抑制効果

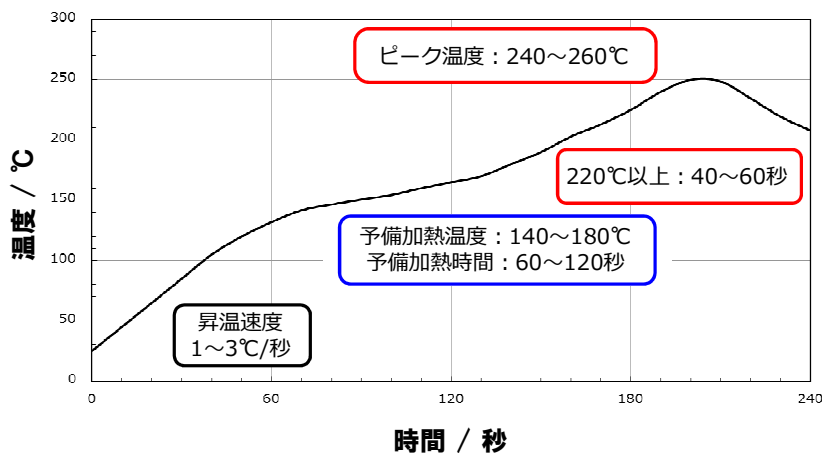
### 優れた加熱だれ抑制効果



### 優れたソルダボール抑制効果



## ◆推奨温度プロファイル



## ◆一般特性

項目		代表特性		試験方法
推奨合金組成		Sn-3.0Ag-0.5Cu		—
粒度		IPC Type.4	IPC Type.5	—
フラックス含有量		11.5 wt%	12.0 wt%	JIS Z 3197
流動特性	粘度	200 Pa・s		JIS Z 3284
	Ti値	0.60		
ハライド含有量		0.02%		JIS Z 3197
フラックスタイプ		ROLO		IPC J-STD-004
100gf以上粘着保持時間		24時間		JIS Z 3284

\*上記特性値は代表値であり保証値ではありません。